

회사 개요 및 연마재

KBM treasures the trust with customers and has been trying to give the highest satisfaction to customers.

케이비엠 회사소개

회사 개요

- 회 사 명 케이비엠 주식회사
- 설 립 일 2000년 11월 11일
- 대표이사
사 장 유병일, 최문석
- 임직원수 68명 (해외법인 포함 107명)
- 매 출 액 497억 원 (해외법인 포함 720억 원)
- 주요사업 초경합금 및 전자부품 제조, 무역

회사 연혁

- 2014. 01 2014 강소기업 선정 (고용노동부)
- 2013. 12 천만불 수출의 탑 수상 (한국무역협회)
- 2012. 09 한일산업협력 지식경제부 장관상 수상
- 2012. 03 SK하이닉스 협력업체 등록
- 2011. 04 HMTECH(주) 설립 (절삭공구 사업 진출)
- 2010. 09 대통령 표창 수상 (자본재 개발 유공)
- 2008. 12 세계일류상품 생산기업 선정 (지식경제부)
- 2007. 06 이노비즈기업 인증 (중소기업기술혁신협회)
- 2007. 02 우수수출중소기업 표창 (중소기업청장)
- 2000. 11 KBM(주) 설립

국내외 법인



KBM CHINA	회 사 명 설 립 일 대표이사 주요사업	케이비엠 차이나 2011년 3월 7일 도 건, 최문석 초경합금 및 전자부품 판매
KBM JAPAN	회 사 명 설 립 일 대표이사 주요사업	케이비엠 재팬 2007년 12월 20일 나카무라 하치로, 유병일 초경합금 및 전자부품 판매
AAT	회 사 명 설 립 일 대표이사 주요사업 홈페이지	Apex Advanced Technology, Inc. 2004년 9월 17일 무라야마 쓰네히코 프로브카드 및 관련제품 제조 및 판매 www.aat-jp.net
HMTECH	회 사 명 설 립 일 대표이사 주요사업 홈페이지	HMTECH (주) 2011년 4월 5일 최문석 절삭공구, 톨홀더 등 유통 www.hmtcorp.co.kr

케이비엠 사업영역 PRODUCTS

절삭공구

선반, 밀링, 드릴링 등 절삭 가공용 공구



터닝인서트



밀링인서트



드릴링인서트



라우터



다이아공구 및 내마모품

다이아공구(레진, 비트리, 전착)
텅스텐 내마모 및 초경 금형



PCD/PCBN/CVD공구



다이아 휠



텅스텐내마모



금형



원재료 및 소재

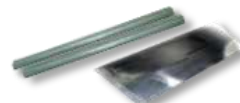
절삭공구 및 내마모 제품 등
초경 합금 제품의 원료 및 소재



W-Powder



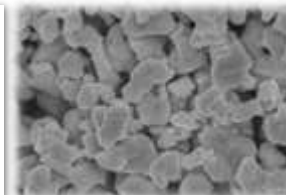
Co/Ni-Powder



Pure W/Mo Parts



Titanium



진공증착

진공증착에 사용되는 열원부품 및
박막형성용 제품



증착코일



증착재



전자빔/이온빔
필라멘트



증착보트



진공증착장비



반도체

반도체 공정에 사용되는 부품 및 장비



프로브카드



프로브핀



M-RAM



이온임플란트용
W/Mo Parts



Moly
Mesh



AlN
Heater Coil



몰리브덴 산암모니움 (Mo)



고순도삼산화몰리브덴



산화지르코니움Z-999 (Zr)



산화비스마스 (Bi)



산화제2주석 (Sn)



세륨연마제 (Ce)



■ 산화 세륨의 주요 용도?

연마재 관련

- 자동차용 글라스
- 액정 패널용 글라스
- 내열용 글라스
- 광학 렌즈
- 태양전지용 초박막 글라스

■ 산화 제2주석의 주요 용도는?

- 글라스 소화제
- 애자 첨가제
- 전자부품용

연마재 공정도

고순도CeO2 A,B,D Grade

전처리

· 이물제거 & 잔류염류제거

소성

· 소성CeO2 균일화

건식 & 습식분쇄

· 목적입도의 조정

건식 & 습식분급

· 목적입도의 조정 & 조립 컷팅

혼합 & 제품

· 제품의 균일화 & 물성, 화학분석

세럼 연마재 제품(Cerium Abrasive)

세럼 연마재

Cerium Oxide Abrasive Powder

제품명	화학식	R ₂ O ₃ (%)	CeO ₂ /R ₂ O ₃ (%)	평균입자경 ^{※1} (μm)	포장
CH-300시리즈	CeO ₂	98.0 이상	99.9 이상	3~4	25kg 종이봉지
CH-500시리즈	CeO ₂	98.0 이상	99.9 이상	0.5~1.5	20kg 종이봉지
CH-600시리즈	CeO ₂	98.0 이상	99.9 이상	1.5~2.5	25kg 종이봉지

세럼 슬러리

Cerium Oxide Abrasive Slurry

제품명	화학식	R ₂ O ₃ (%)	CeO ₂ /R ₂ O ₃ (%)	평균입자경 ^{※1} (μm)	포장
세럼 슬러리 (L 0)	CeO ₂	39.0~41.0	99.0 이상	0.1~0.3	25kg bag-in-box

제품 Line Up

CH 601 ⇒ 입도가 1.8 μ 전후로 황삭 연마에 적합.

BS 520 ⇒ 입도가 1.0 μ 전후로 황삭 연마 후의 중간 연마에 적합.

CH 501 ⇒ 입도가 0.7 μ 정도로 정삭 연마에 적합.

D3A ⇒ 입도가 0.8 μ 전후로 중간 연마와 정삭 연마에 적합.

* D3A 추천.

타사 제품과의 차이

당사 연마재

- **CeO₂ 성분 99%**
- **환경을 중시한 불소 free**
- **연마력을 높이기 위한 친환경 첨가제 선택**

타사 연마재

- CeO₂ 순분 70%정도의 혼합 희토
- 연마력에 필요한 불소 함유

Thank You

Your Best Partner !



(06123) 韓国ソウル特別市 江南区 奉恩路116 F階
TEL : +82-2-2098-7000 FAX : +82-2-2098-7099 www.kbmcorp.co.kr